

溶射を中心とした各種表面改質の総合メーカー

2023年3月期 第2四半期決算 補足説明資料

2022年11月9日

- 1 . 第 2 四半期連結決算の概要
- 2 . 2023年 3 月期 連結業績予想
- 3 . 中期経営計画の進捗状況

1. 第2四半期連結決算の概要

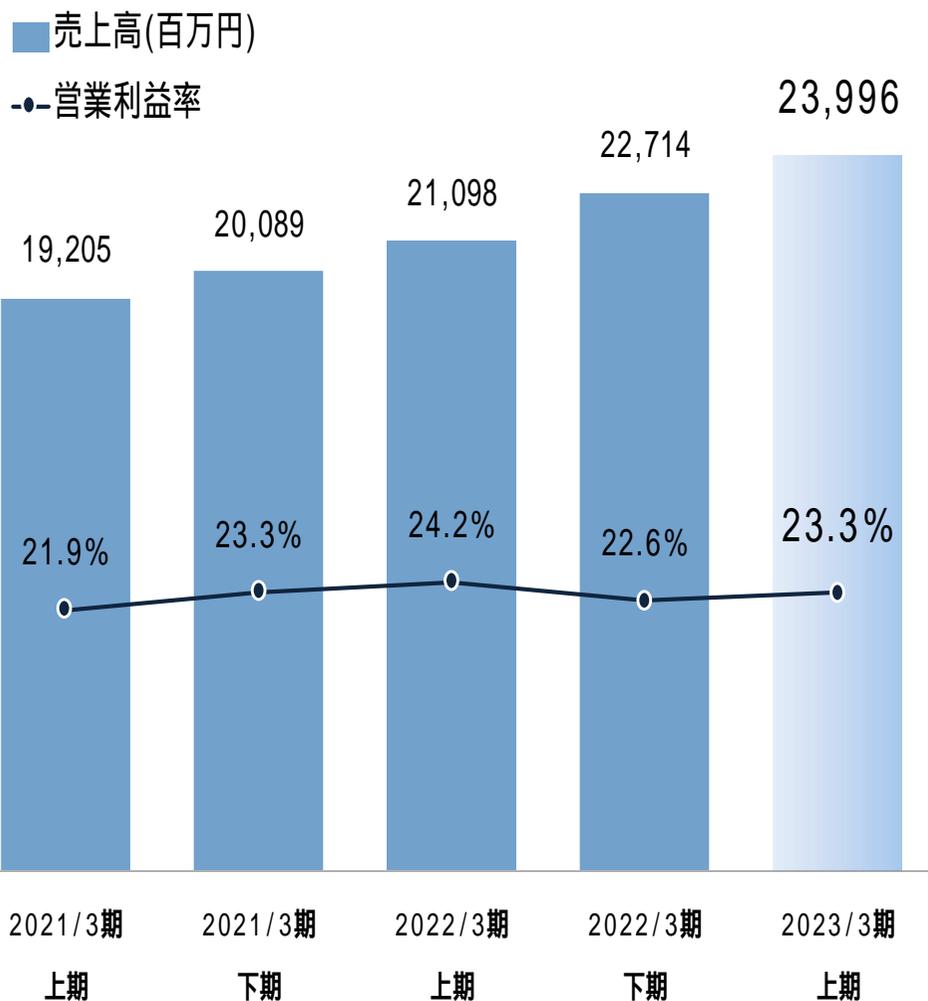
ハイライト

-  (1) 上半期として売上・利益ともに過去最高を更新
「半導体・FPD」「鉄鋼」が増収基調で推移
それ以外の分野も概ね予想どおりの進捗
-  (2) 海外子会社 増収増益
中国、台湾においても
半導体、鉄鋼関連の受注が好調

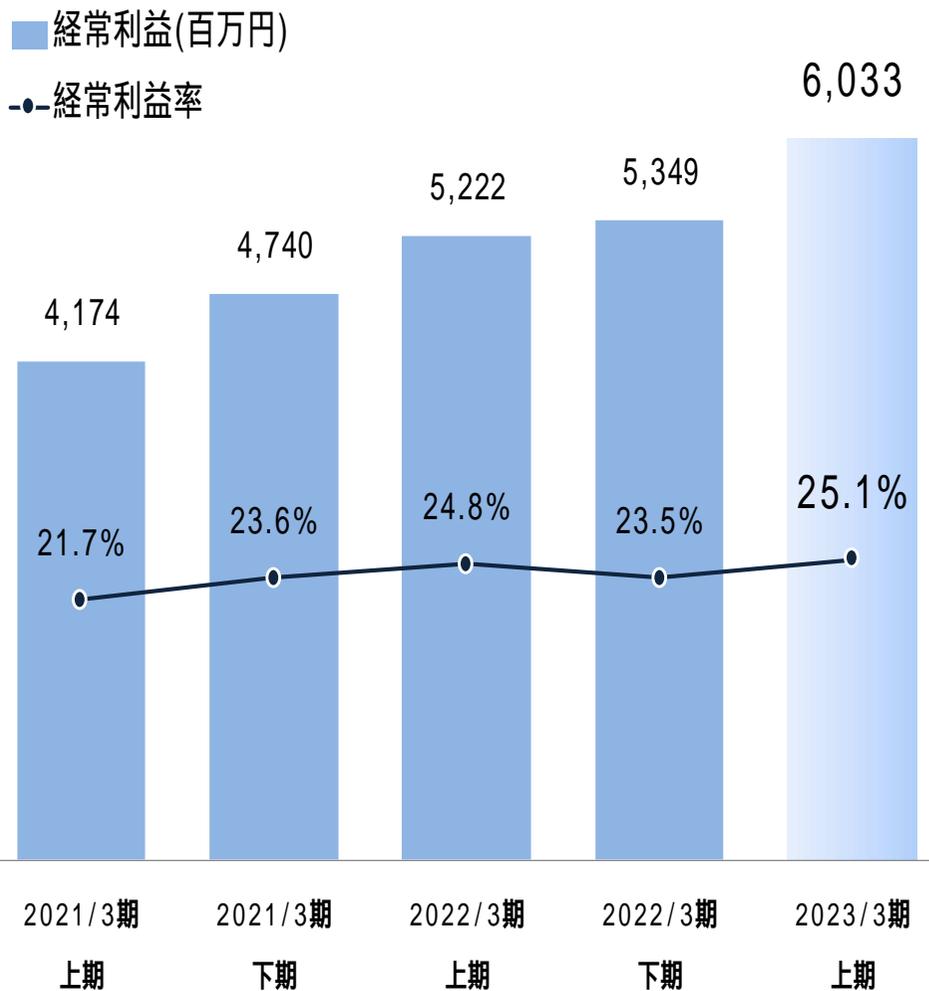
第2四半期連結決算 実績概要



売上高と営業利益率



経常利益と経常利益率



(注) 2022/3期より「受取ロイヤリティー等」の計上区分を営業外収益から売上高に変更しており、過年度もこの変更を反映した組替え後の数値を記載しています。

第2四半期連結決算 実績概要



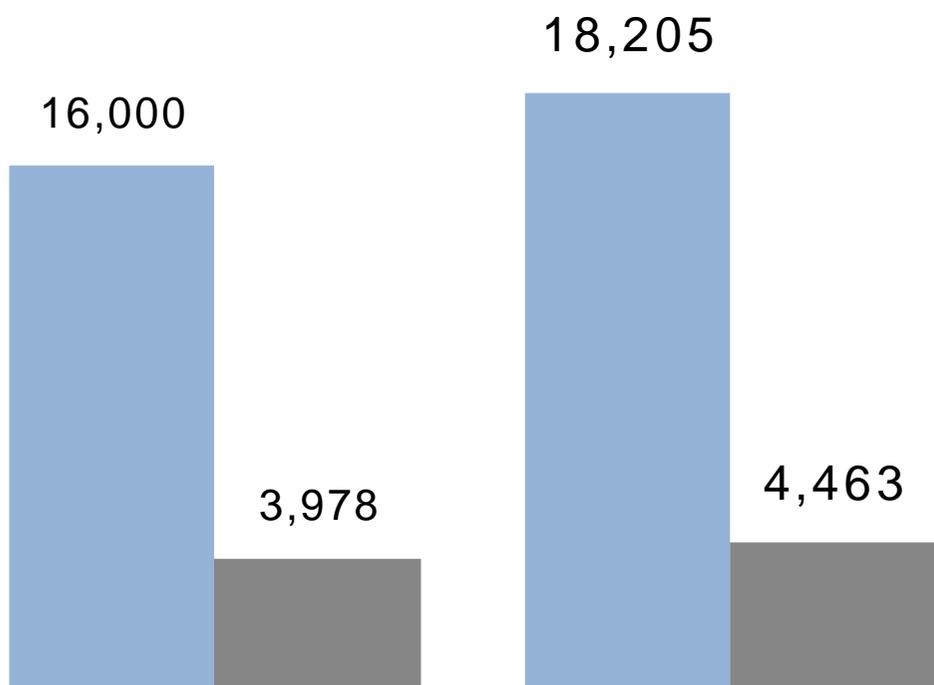
(百万円)	2022/3期		2023/3期		前年同期比増減	
	実績	2 Q 構成比	実績	2 Q 構成比	金額	率
売上高	21,098	100.0%	23,996	100.0%	2,898	13.7%
溶射加工(単体)	16,000	75.8%	18,205	75.9%	2,205	13.8%
半導体・FPD	9,938	47.1%	12,100	50.4%	2,162	21.8%
産業機械	1,757	8.3%	1,739	7.2%	17	-1.0%
鉄鋼	1,623	7.7%	1,775	7.4%	151	9.4%
その他	2,680	12.7%	2,588	10.9%	91	-3.4%
その他表面処理加工	1,195	5.7%	1,367	5.6%	171	14.4%
国内子会社	1,206	5.7%	1,197	5.0%	9	-0.8%
海外子会社	2,615	12.4%	3,140	13.1%	524	20.0%
受取ロイヤリティー等	80	0.4%	86	0.4%	6	7.7%
営業利益	5,111	24.2%	5,581	23.3%	469	9.2%
経常利益	5,222	24.8%	6,033	25.1%	810	15.5%
親会社株主に帰属する 四半期純利益	3,448	16.3%	3,919	16.3%	471	13.7%

セグメント情報

溶射加工(単体)

■ 売上高(百万円)

■ セグメント利益(百万円)



2022/3期 2Q

2023/3期 2Q

産業機械およびその他分野は若干の減収となるも、半導体・FPD分野と鉄鋼分野が伸長し、増収増益

国内子会社

1,206

245

2022/3期 2Q

1,197

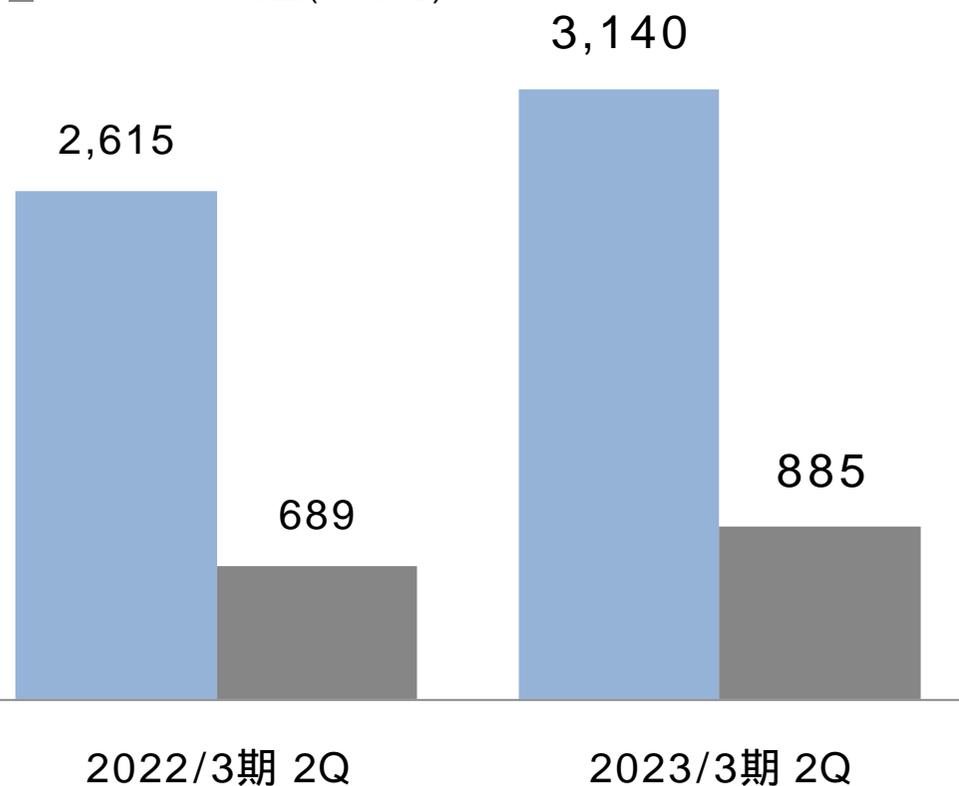
175

2023/3期 2Q

国内自動車メーカーの生産停滞の影響を受け、切削工具関係の受注が低調で、減収減益

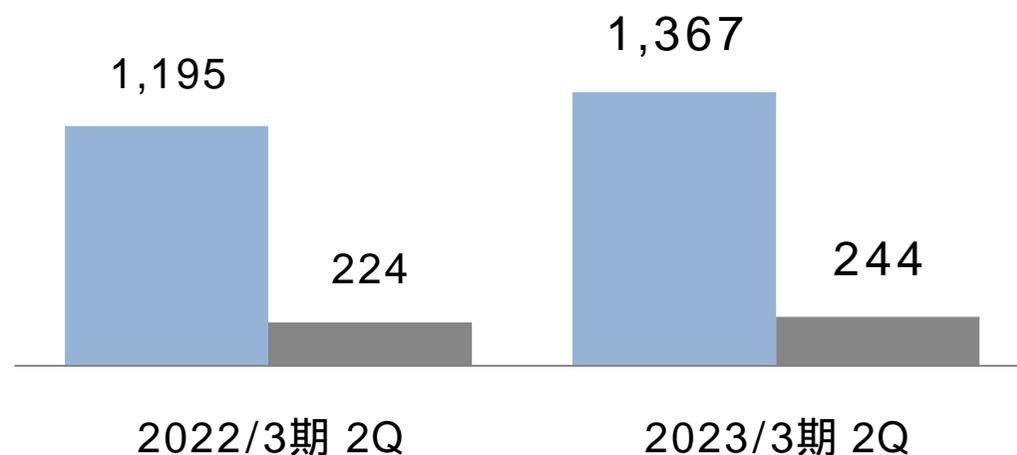
海外子会社

- 売上高(百万円)
- セグメント利益(百万円)



中国、台湾での半導体関連、鉄鋼関連の受注が好調で、増収増益

その他表面処理加工



農業機械部品向け等の受注が増加傾向にあり、増収増益

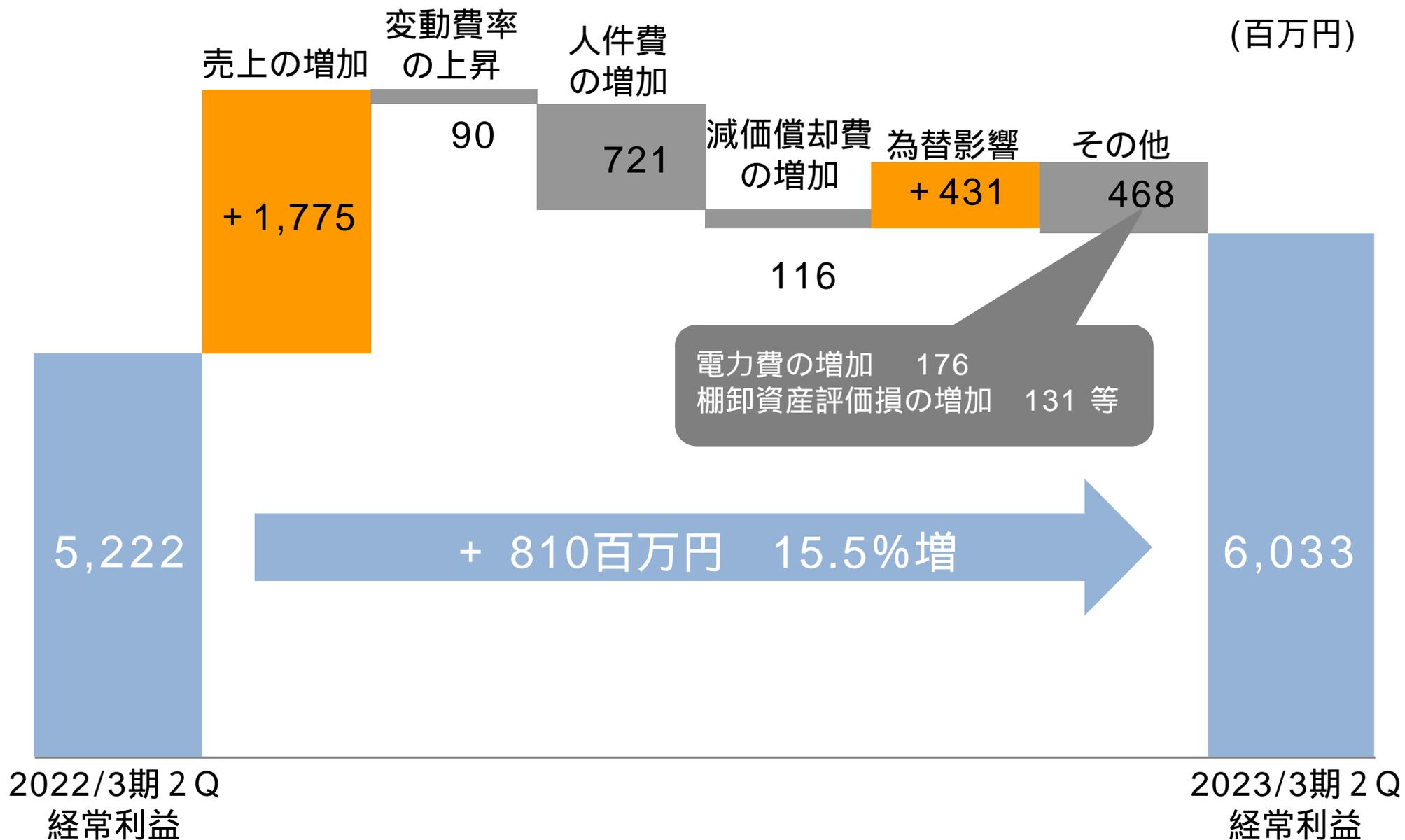
セグメント情報



(百万円)	2022/3期 2Q		2023/3期 2Q		前年同期比増減			
					売上高		セグメント利益	
	売上高	セグメント利益	売上高	セグメント利益	金額	率	金額	率
溶射加工(単体)	16,000	3,978	18,205	4,463	2,205	13.8%	485	12.2%
国内子会社	1,206	245	1,197	175	9	-0.8%	70	-28.7%
海外子会社	2,615	689	3,140	885	524	20.0%	195	28.4%
その他表面処理加工	1,195	224	1,367	244	171	14.4%	19	8.7%
合計	21,017	5,138	23,909	5,768	2,892	13.8%	630	12.3%

(注) 売上高のうち「受取ロイヤリティー等」は含まれておりません。

前年同期比 経常利益 増減要因分析



財政状態



(百万円)	2022/3期		2023/3期
	2 Q末	4 Q末	2 Q末
総資産	66,430	69,517	72,454
自己資本	46,633	49,099	52,170
自己資本比率	70.2%	70.6%	72.0%
有利子負債残高	5,073	4,249	3,526

- ・ 総資産は前期末比 29億36百万円の増加（流動資産の増加 31億27百万円）
- ・ 自己資本比率は前期末比1.4ポイント上昇の72.0%
- ・ 有利子負債は前期末比 7億23百万円の減少（新規借入なし）

キャッシュ・フローの状況



(百万円)	2022/3期	2023/3期
	2 Q	2 Q
営業キャッシュ・フロー	4,706	5,005
投資キャッシュ・フロー	1,820	1,353
財務キャッシュ・フロー	2,494	2,430
現金及び現金同等物の期末残高	19,174	20,650

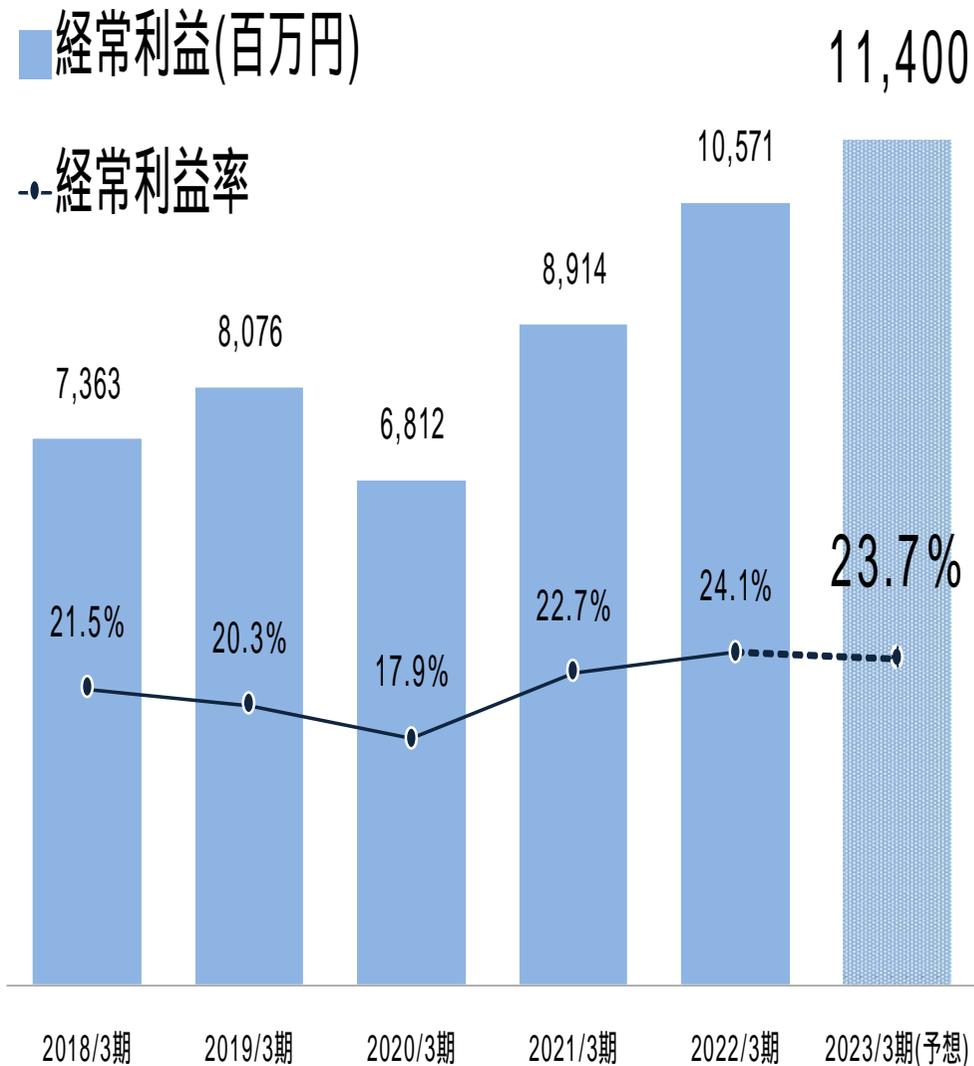
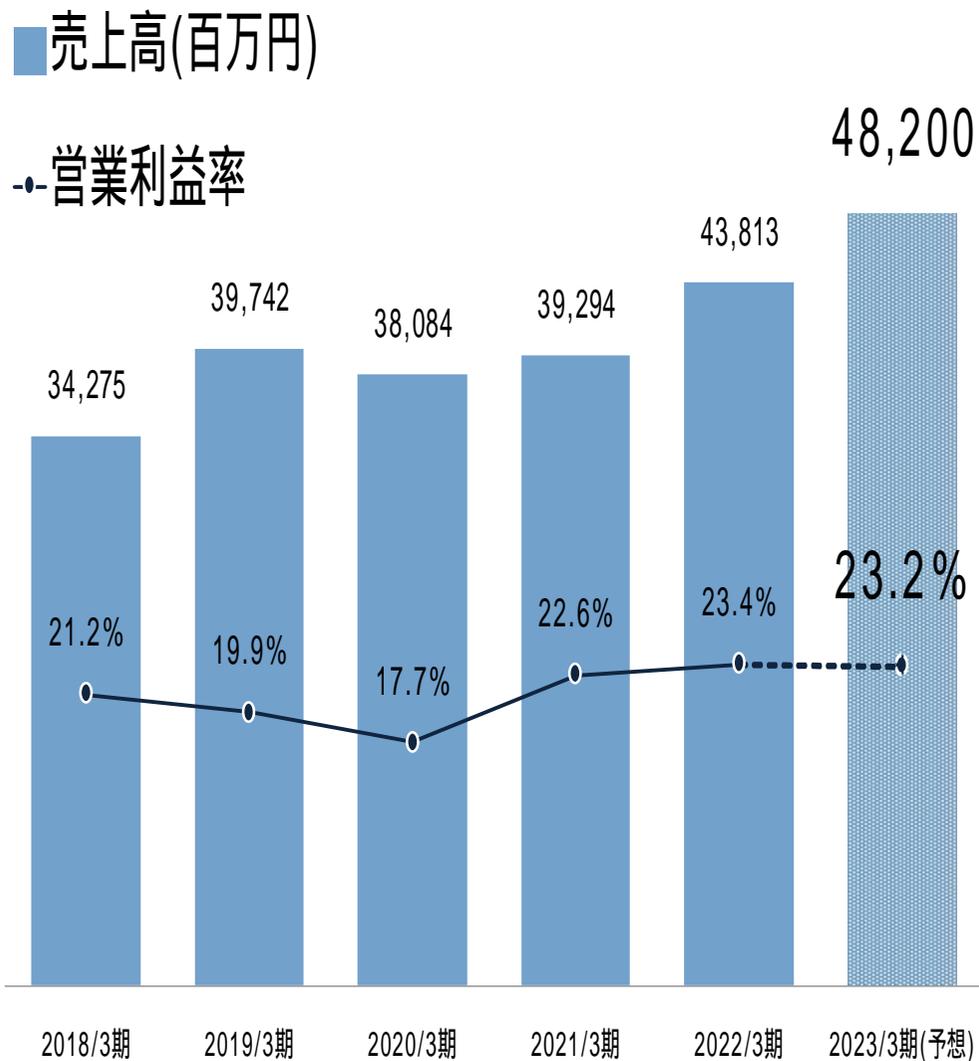
- ・ 当期のフリーキャッシュ・フロー（営業CF + 投資CF）は + 36億円
- ・ 投資CF / 有形固定資産の取得 前期： 18億円 当期： 9億円
- ・ 財務CF / 配当金の支払額 前期： 13億円 当期： 15億円

2. 2023年3月期 連結業績予想

2023年3月期 連結業績予想の概要



前回（2022年7月29日）発表の業績予想から変更なし



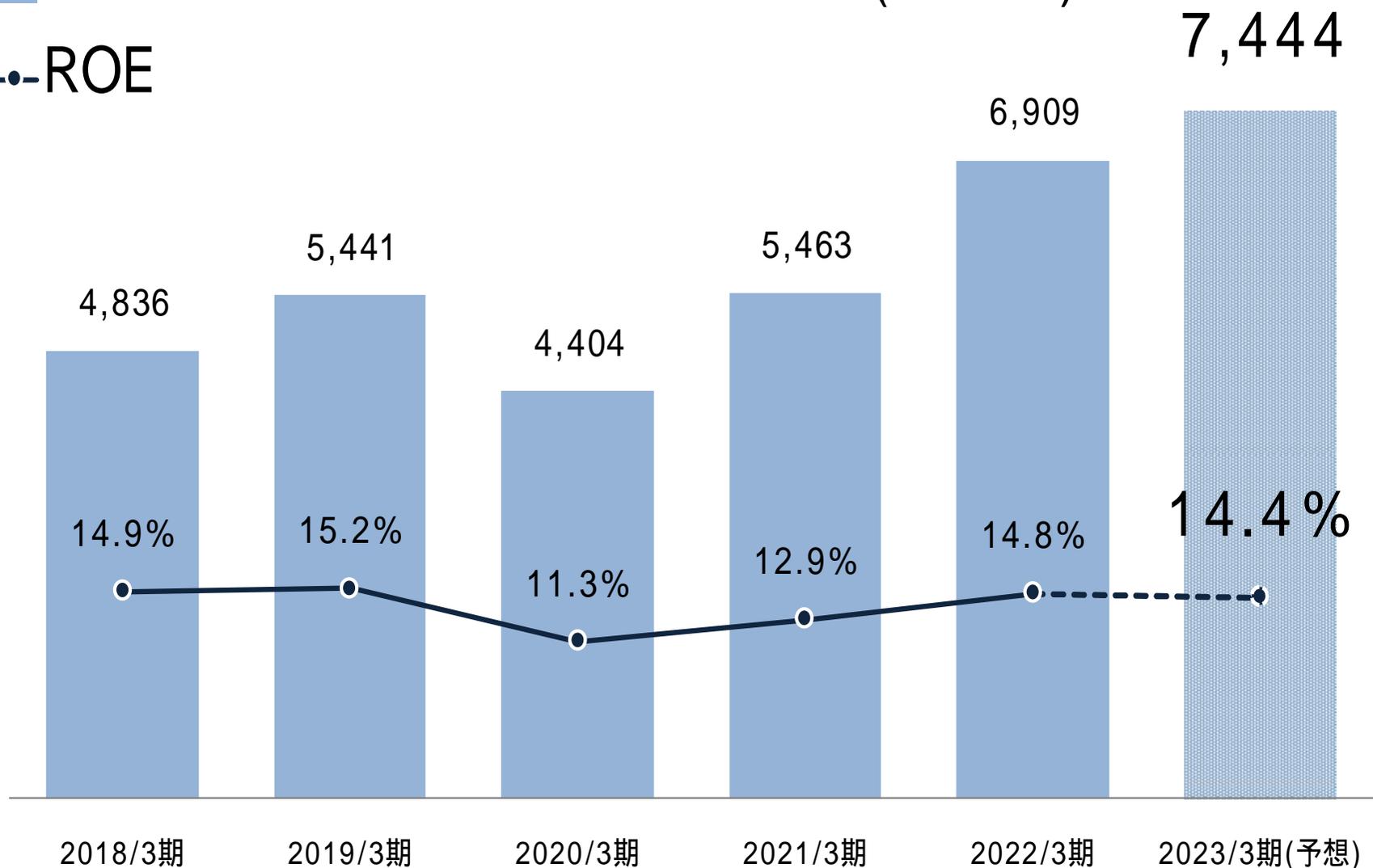
(注) 2022/3期より「受取ロイヤリティ等」の計上区分を営業外収益から売上高に変更しており、過年度もこの変更を反映した組替え後の数値を記載しています。

2023年3月期 連結業績予想の概要



■ 親会社株主に帰属する当期純利益(百万円)

---ROE



2023年3月期 連結業績予想



(百万円)	2022/3期		2023/3期		前期実績比増減	
	実績	構成比	7/29発表予想	構成比	金額	率
売上高	43,813	100.0%	48,200	100.0%	4,386	10.0%
溶射加工(単体)	33,043	75.4%	36,788	76.3%	3,744	11.3%
半導体・FPD	20,643	47.1%	23,968	49.7%	3,324	16.1%
産業機械	3,707	8.5%	3,819	7.9%	111	3.0%
鉄鋼	3,450	7.9%	3,639	7.5%	188	5.5%
その他	5,242	11.9%	5,362	11.2%	119	2.3%
その他表面処理加工	2,502	5.7%	2,638	5.5%	135	5.4%
国内子会社	2,399	5.5%	2,457	5.1%	57	2.4%
海外子会社	5,695	13.0%	6,137	12.7%	441	7.7%
受取ロイヤリティー等	171	0.4%	180	0.4%	8	5.2%
営業利益	10,255	23.4%	11,200	23.2%	944	9.2%
経常利益	10,571	24.1%	11,400	23.7%	828	7.8%
親会社株主に帰属する 当期純利益	6,909	15.8%	7,444	15.4%	534	7.7%

2023年3月期 第2四半期 進捗率

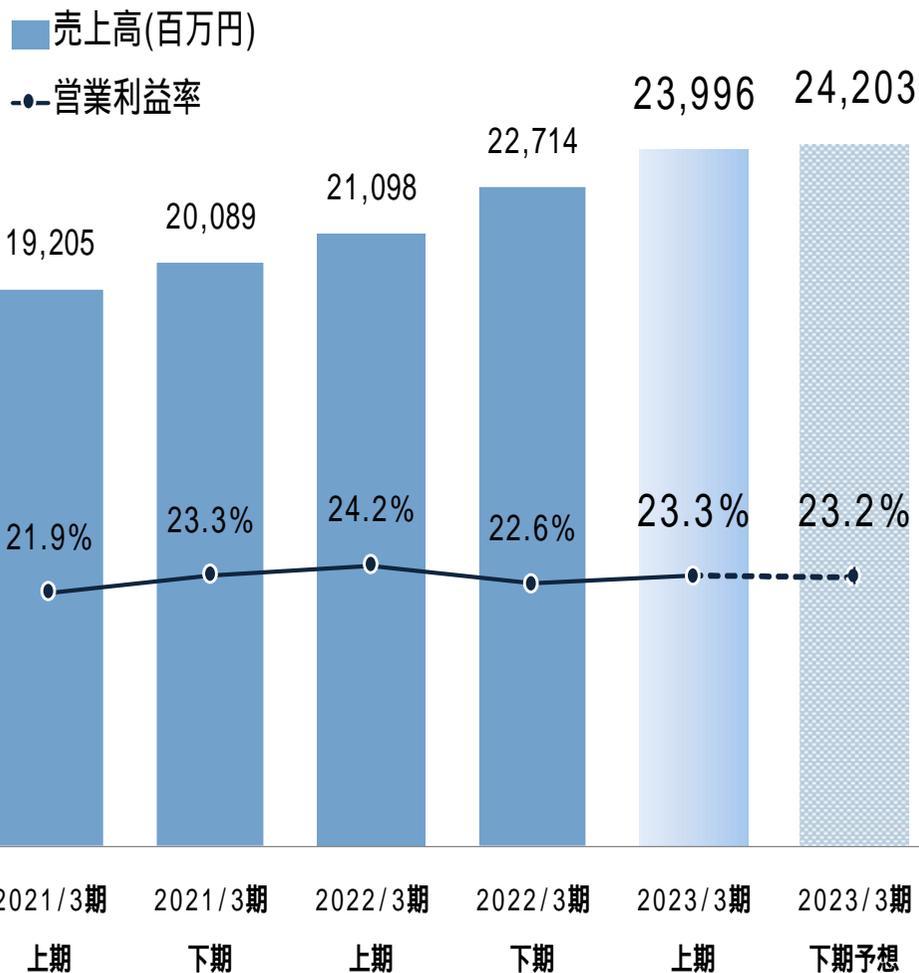


(百万円)	2023/3期		2023/3期		2 Q実績 進捗率
	実績	2 Q 構成比	予想	通期 構成比	
売上高	23,996	100.0%	48,200	100.0%	49.8%
溶射加工(単体)	18,205	75.9%	36,788	76.3%	49.5%
半導体・FPD	12,100	50.4%	23,968	49.7%	50.5%
産業機械	1,739	7.2%	3,819	7.9%	45.6%
鉄鋼	1,775	7.4%	3,639	7.5%	48.8%
その他	2,588	10.9%	5,362	11.2%	48.3%
その他表面処理加工	1,367	5.6%	2,638	5.5%	51.8%
国内子会社	1,197	5.0%	2,457	5.1%	48.7%
海外子会社	3,140	13.1%	6,137	12.7%	51.2%
受取ロイヤリティー等	86	0.4%	180	0.4%	48.3%
営業利益	5,581	23.3%	11,200	23.2%	49.8%
経常利益	6,033	25.1%	11,400	23.7%	52.9%
親会社株主に帰属する 当期(四半期)純利益	3,919	16.3%	7,444	15.4%	52.7%

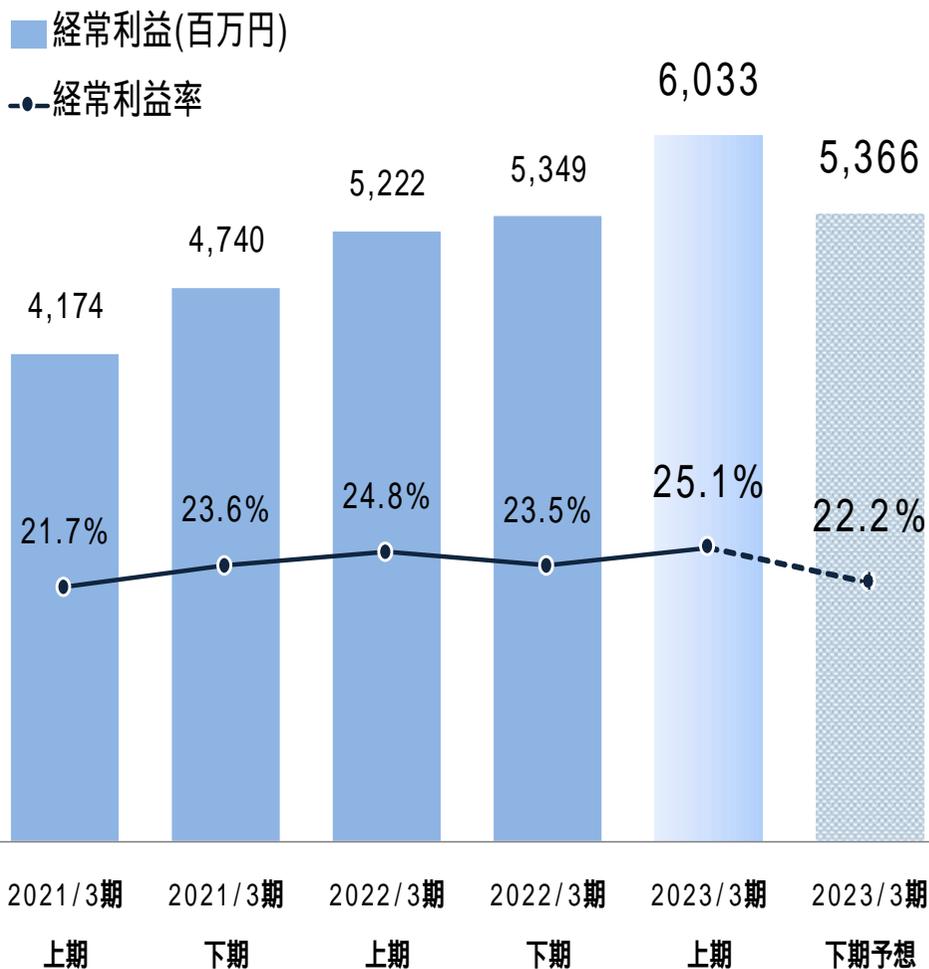
2023年3月期 下期予想



売上高と営業利益率



経常利益と経常利益率



(注) 2022/3期より「受取ロイヤリティー等」の計上区分を営業外収益から売上高に変更しており、過年度もこの変更を反映した組替え後の数値を記載しています。

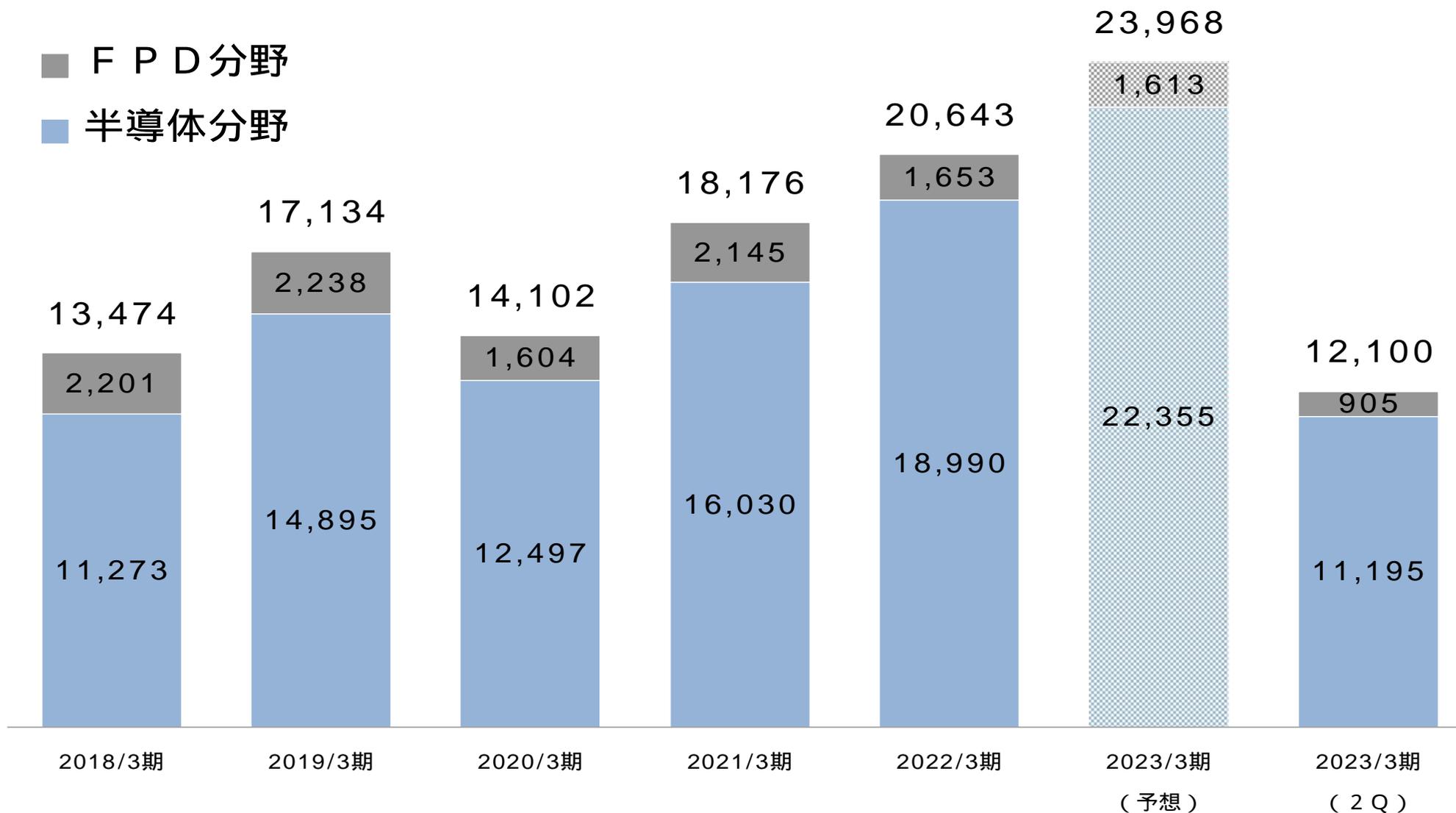
半導体・F P D分野の売上推移



(百万円)

溶射加工(単体)

- F P D分野
- 半導体分野

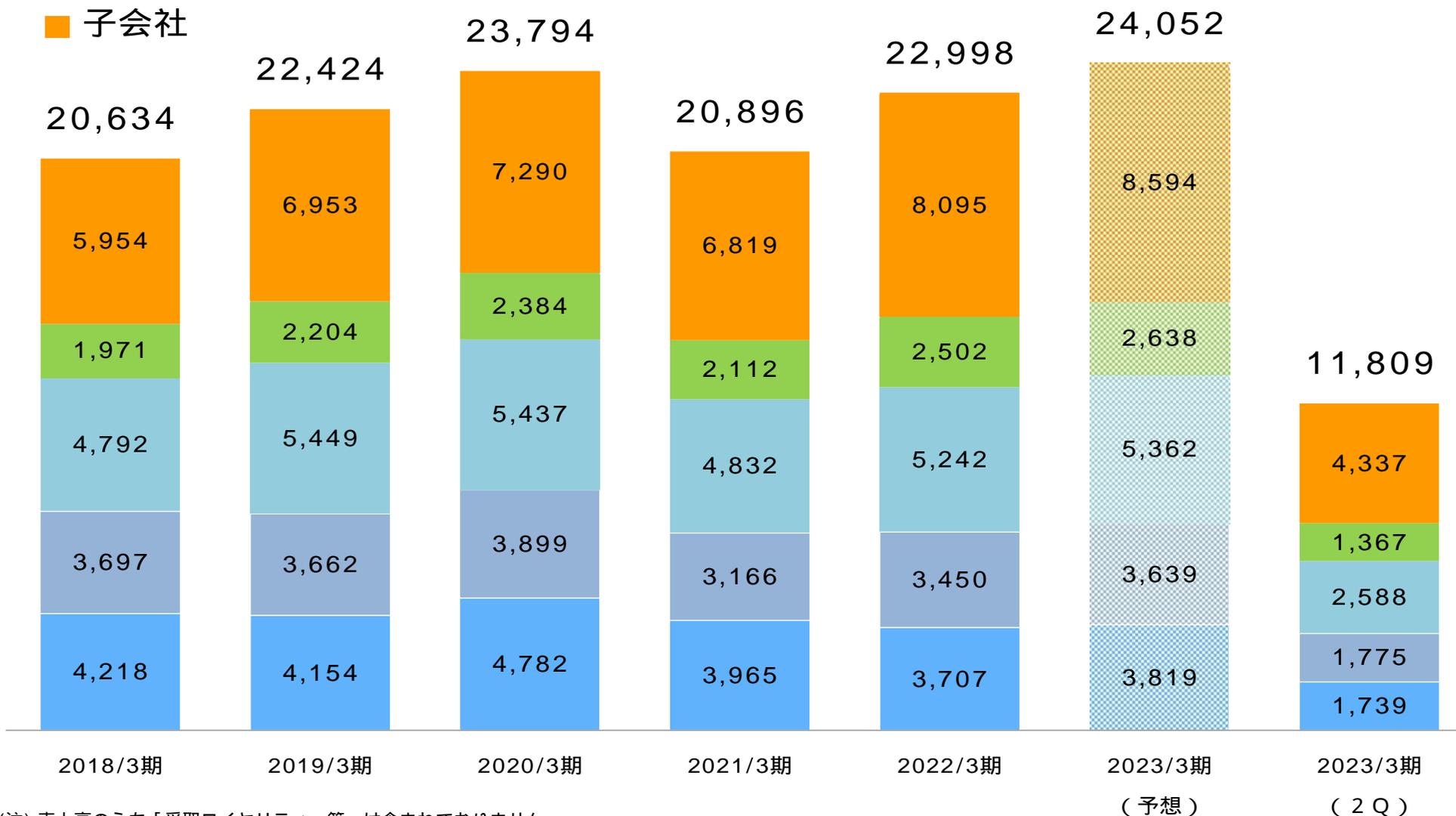


半導体・FPD分野以外の売上推移



(百万円)

- 産業機械分野
- 鉄鋼分野
- その他溶射
- その他表面処理
- 子会社



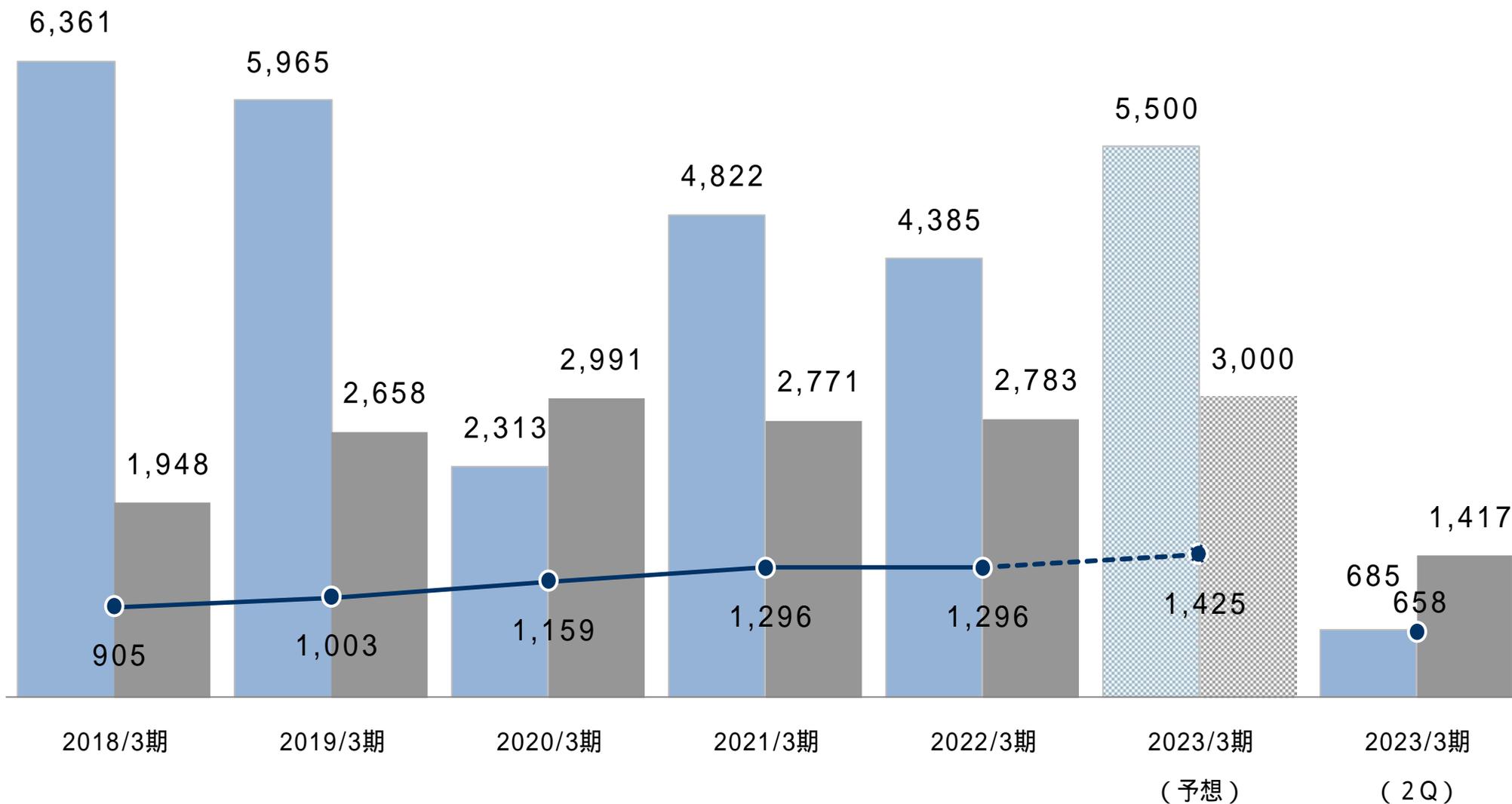
(注) 売上高のうち「受取ロイヤリティ等」は含まれておりません。

設備投資額・減価償却費・研究開発費



■ 設備投資額 ■ 減価償却費 ●-研究開発費

(百万円)



設備投資計画について

2023年3月期

設備投資予定額 55億円

(期初予定から変更なし)

トーカロ

東京・明石・北九州工場を中心に

生産能力増強など 35億円

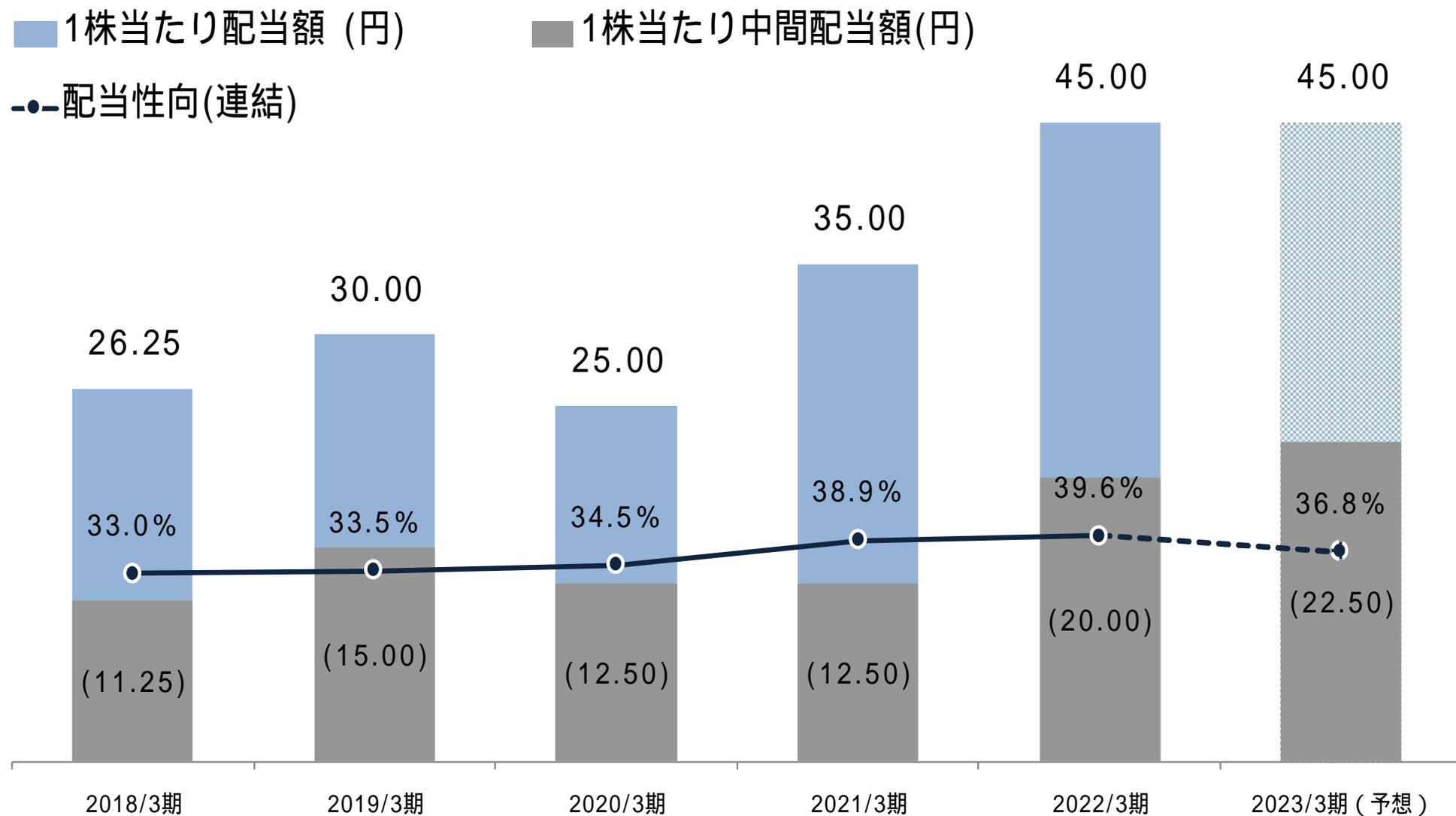
国内子会社

生産能力増強など 2億円

海外子会社

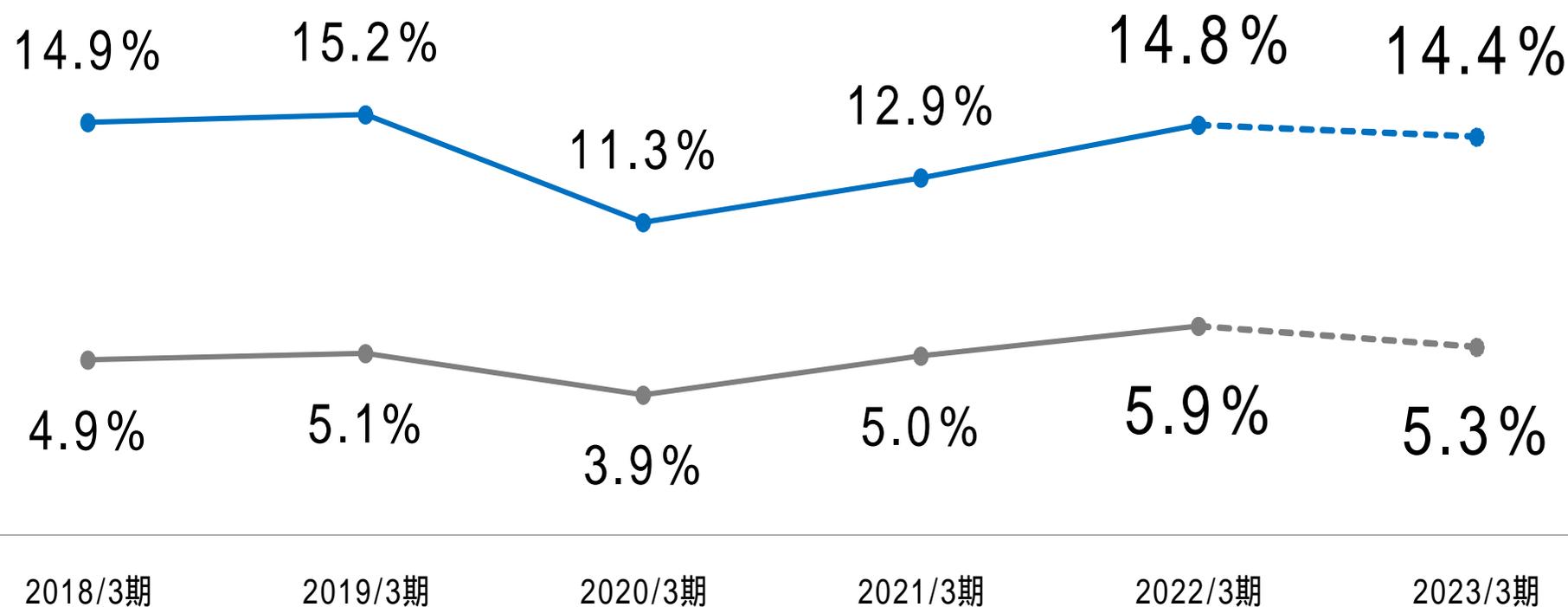
漢泰国際電子(台湾)での新工場建設ほか 18億円

1株当たり配当額・配当性向の推移



ROE・純資産配当率の推移

● ROE ● 純資産配当率



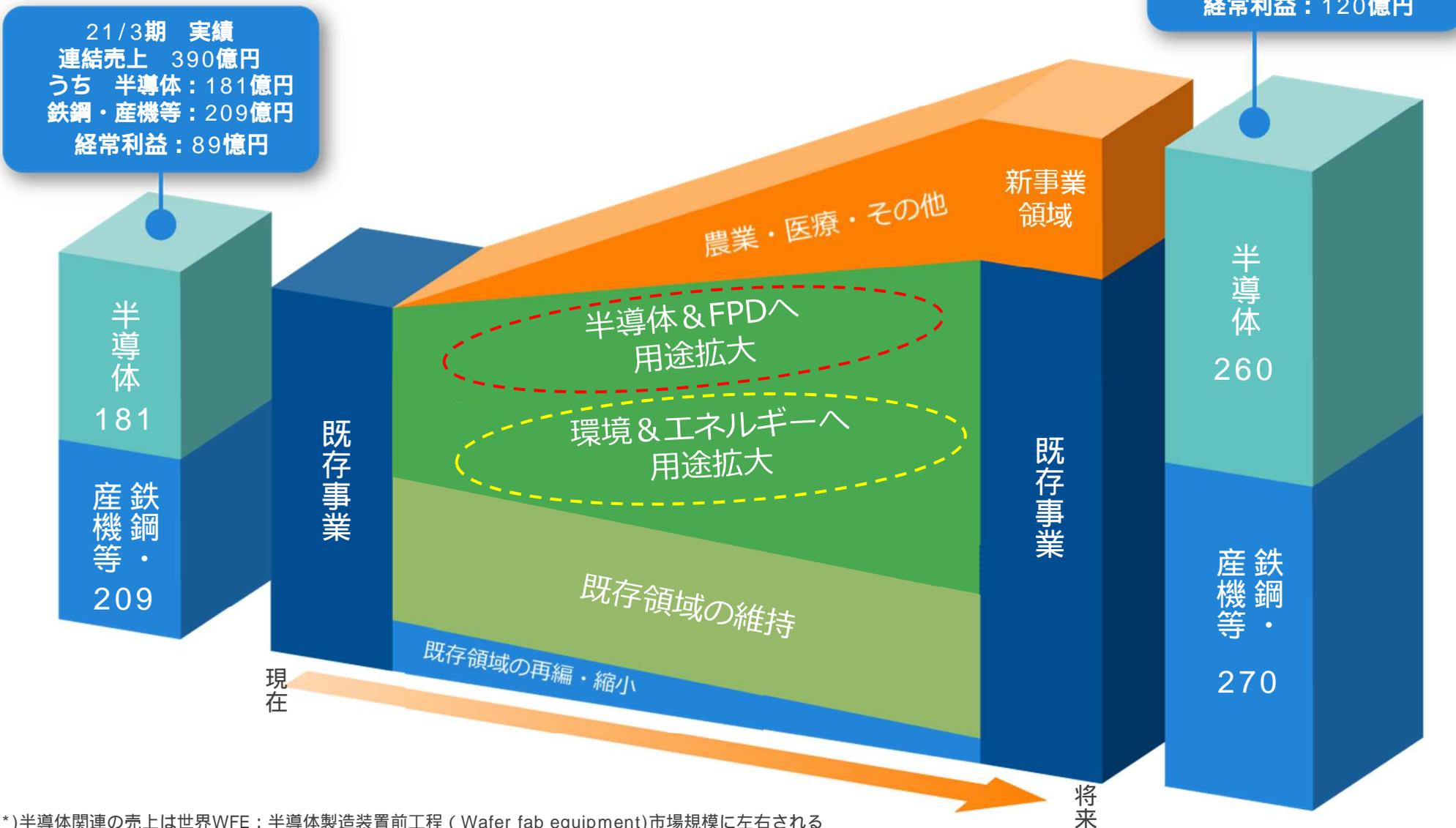
ROE (自己資本利益率) = 当期純利益 / 期中平均自己資本

純資産配当率 = 1株当たり配当金 / 期中平均1株当たり純資産 (= ROE × 配当性向)

3 . 中期経営計画の進捗状況

持続的成長イメージ（中期経営計画）

将来の事業構成について



(*)半導体関連の売上は世界WFE：半導体製造装置前工程（Wafer fab equipment）市場規模に左右される

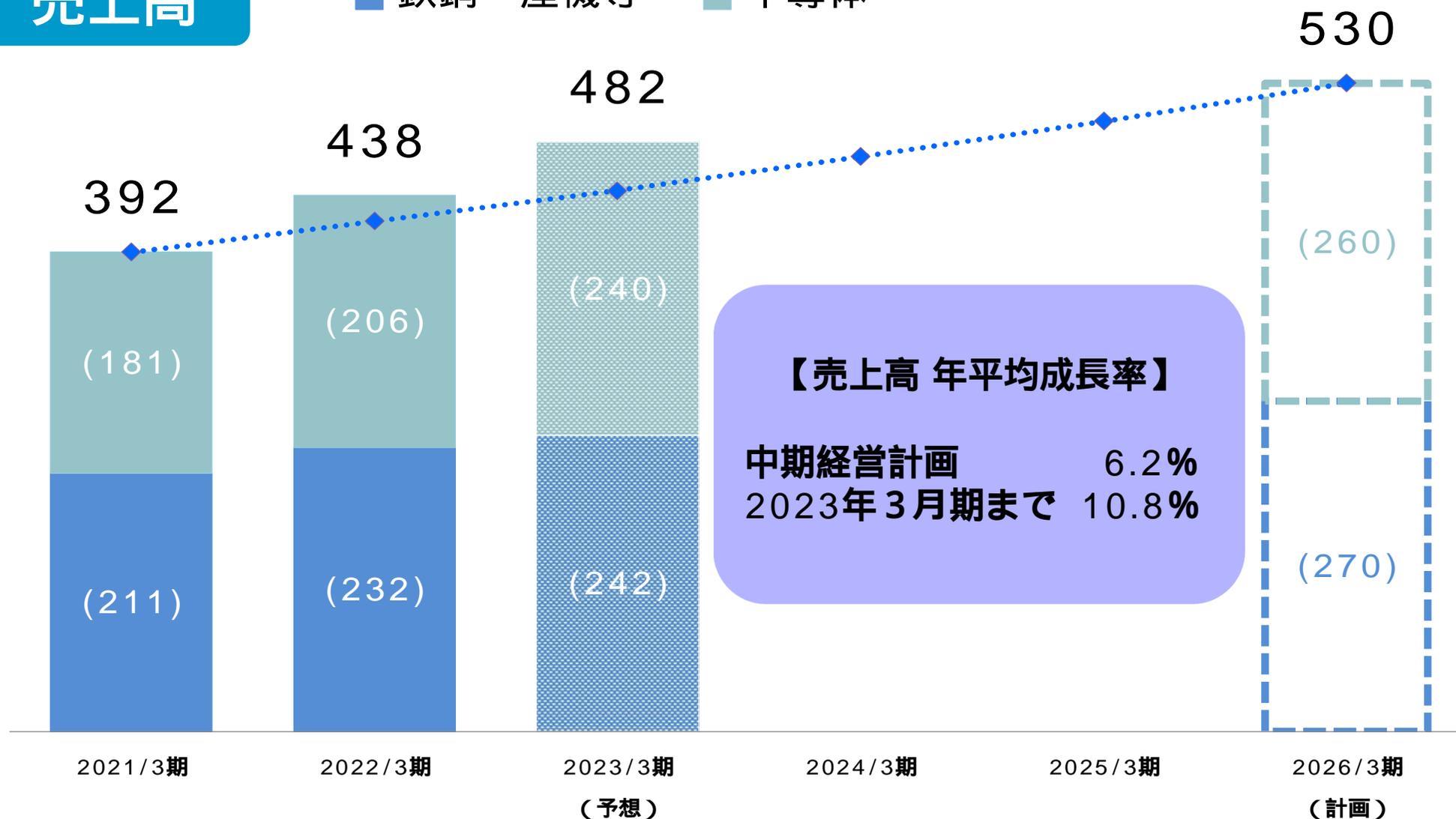
中期経営計画（数値目標）の進捗状況



売上高

■ 鉄鋼・産機等 ■ 半導体

(億円)



(注) 2022/3期より「受取ロイヤリティ等」の計上区分を営業外収益から売上高に変更しており、2021/3期の「受取ロイヤリティ等」2億円は「鉄鋼・産機等」の売上高に含めております。

中期経営計画（数値目標）の進捗状況



「半導体」の売上高

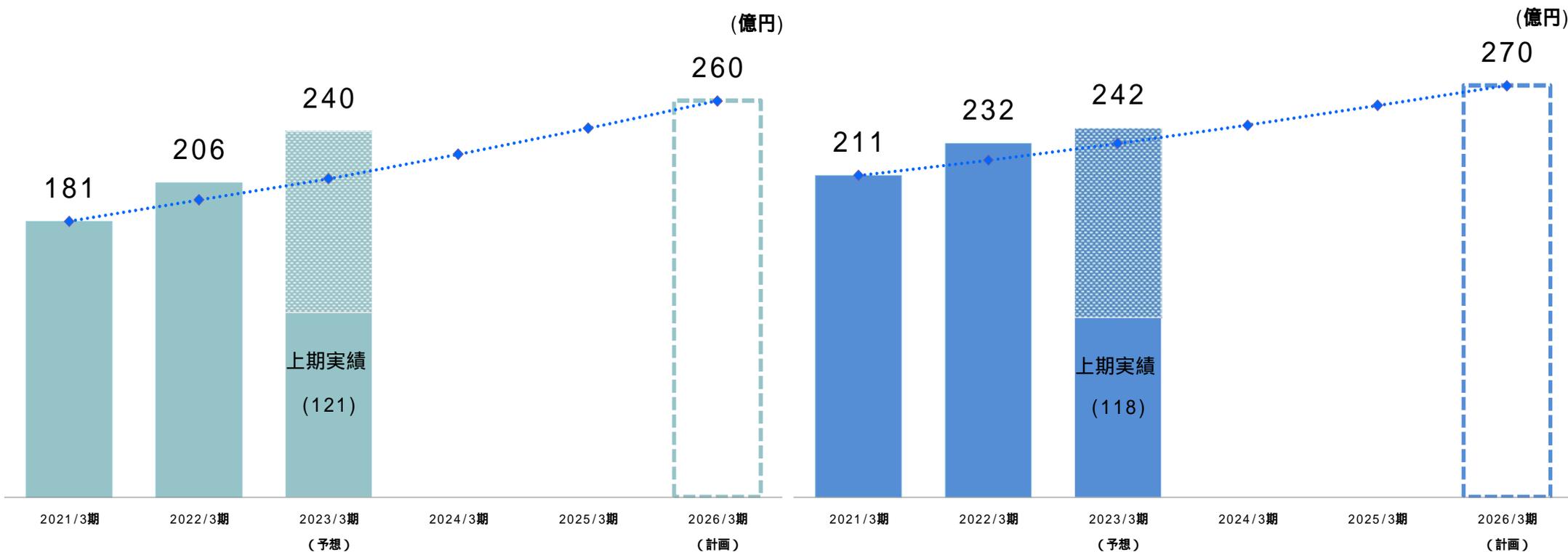
「鉄鋼・産機等」の売上高

【売上高 年平均成長率】

中期経営計画 7.4%
2023年3月期まで 14.8%

【売上高 年平均成長率】

中期経営計画 5.0%
2023年3月期まで 7.1%



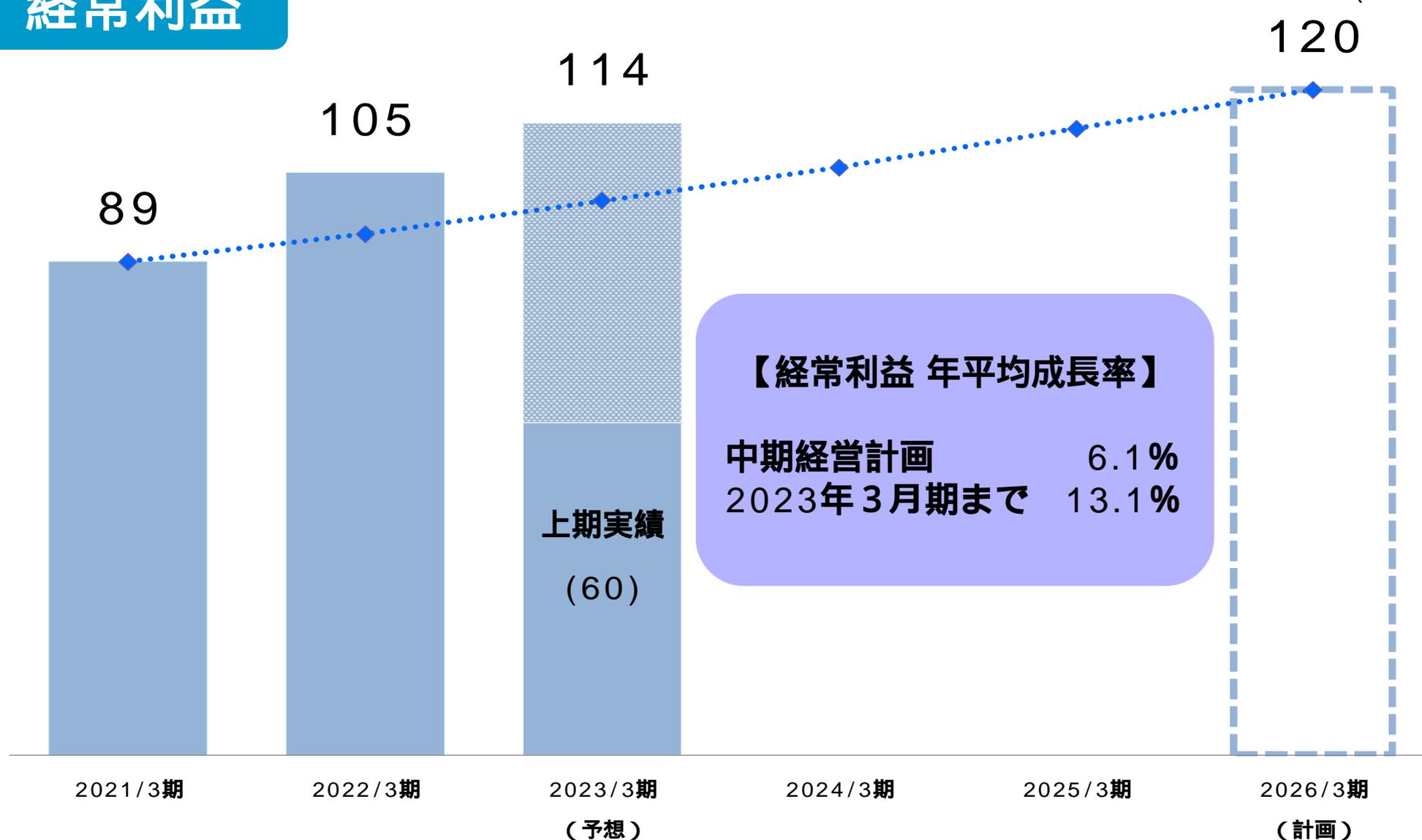
(注) 2022/3期より「受取ロイヤリティ等」の計上区分を営業外収益から売上高に変更しており、2021/3期の「受取ロイヤリティ等」2億円は「鉄鋼・産機等」の売上高に含めております。

中期経営計画（数値目標）の進捗状況



経常利益

(億円)



経営指標ハイライト



(百万円)	2018/3期 実績	2019/3期 実績	2020/3期 実績	2021/3期 実績	2022/3期 実績	2023/3期 予想
受注高	36,851	38,915	38,011	39,021	45,394	-
受注残高	6,725	6,081	6,195	6,143	7,896	-
売上高	34,275	39,742	38,084	39,294	43,813	48,200
営業利益	7,270	7,905	6,727	8,890	10,255	11,200
経常利益	7,363	8,076	6,812	8,914	10,571	11,400
経常利益率	21.5%	20.3%	17.9%	22.7%	24.1%	23.7%
親会社株主に帰属する 当期純利益	4,836	5,441	4,404	5,463	6,909	7,444
1株当たり当期純利益 (EPS)	79.56	89.51	72.45	89.86	113.62	122.36
総資産	52,664	57,278	61,122	64,183	69,517	75,452
自己資本	34,174	37,559	40,263	44,201	49,099	54,325
自己資本比率	64.9%	65.6%	65.9%	68.9%	70.6%	72.0%
自己資本利益率 (ROE)	14.9%	15.2%	11.3%	12.9%	14.8%	14.4%
総資産経常利益率 (ROA)	15.2%	14.7%	11.5%	14.2%	15.8%	15.7%
投下資本利益率 (ROIC)	13.6%	13.3%	9.8%	11.9%	13.0%	13.2%

ROE = 親会社株主に帰属する当期純利益/期中平均自己資本、ROA = 経常利益/期中平均総資産、ROIC = 税引後営業利益/期中平均投下資本

売上高及び営業利益は、2022/3期の表示方法の変更(「受取ロイヤリティー等」の計上区分を営業外収益から売上高に変更)を反映した組替え後の数値です。

本資料における将来に関する記述は、発表日現在、当社が入手可能な情報に基づいて判断したものであり、今後のさまざまな要因により、実際の業績等はこれら見通しと大きく異なる結果となる可能性があります。

お問い合わせ先

トーカロ株式会社

経営企画室

TEL: 078-303-3433 (代)